

NANOSTRU WHEELS

ナノストラホイール



お客様のご要求

パワー半導体用ウエハの加工において

- ・ 潜傷を浅くしCMP量を減らしたい
- ・ 平滑性、表面あらさを良くしたい
- ・ 高能率で加工したい

そんなホイールが出来ないか？



ナノストラホイールを開発！

NANOSTRUの特長

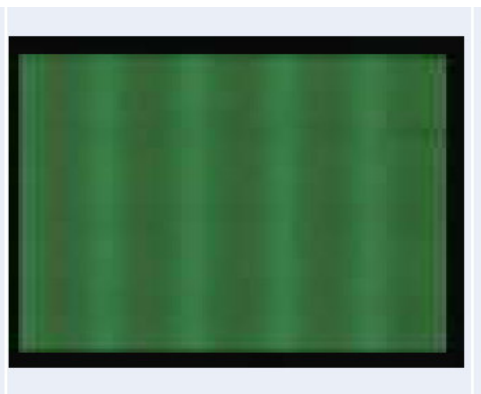
- ◆ サブミクロン原材料を高分散配合
砥粒の凝集を抑制し砥粒・結合剤・気孔の最高クラスの均一分散を実現
 - ・ 潜傷の低減と平滑・表面あらさの向上
 - ・ サブミクロンサイズの砥粒における高加工レートを実現

適用粒度

結合剤	特殊ファイナセラミックスボンド [®] NS08 (超仕上)
粒度	#2000～#50000

研削例

研削形態：ロータリーインフィード研削
被削材：SiC ウエハ 4インチ
使用砥石：SD #50,000
加工結果：潜傷深さ 1 μ m、Ra 0.5nm、加工レート 1.8 μ m/min



↑ CMP 1 μ m 除去、KOH エッチング処理後のレーザー顕微鏡画像

ZYGO による二次元面あらさ測定画像→

